**UPDATE FANIA**

Revisi bagian casing

|  |  |
| --- | --- |
| **Revisi** | **Desain** |
| Ukuran lubang untuk angin pada casing sensor kurang besar |  |
| Beri lubang pada tempat sensor storage untuk keluar air (jika ada air) |  |
| Casing atas menutup casing bawah untuk melindungi air masuk ke dalam |  |
| Beri penutup pada akses SD card |  |
| Beri coakan untuk penamaan dan penamaan menggunakan stiker |  |
| Tulisan ERSA x HMJ emboss ke dalam |  |
| Untuk DC jack desainnya jangan lubang (coakan case bawah ditutup oleh case atas) |  |
| Tebal top case pada bagian layar terlalu besar dan bagian putih tertutupi (Diberi pembatas sekeliling layar dan pada bagian display tebal casing dikurangi 1 mm) |  |
| Bagian bawah bottom case untuk sensor kasih metal yg bulat dan tambah kaki karet (pin metal beli dari bahan untuk bros) |  |